

SEMI事業（半導体後工程製造装置）説明会

世界トップクラスのトータルソリューション企業に向けた成長戦略

2026年9月10日

ヤマハ発動機株式会社
ヤマハロボティクス株式会社



■ 1：ロボティクス事業の概要

ヤマハ発動機株式会社
執行役員ソリューション事業本部長 江頭綾子

■ 2：ヤマハロボティクス SEMI事業成長戦略

ヤマハロボティクス株式会社
代表取締役社長 中村亮介

- ・ ヤマハロボティクス SEMI事業について
- ・ 半導体後工程について
- ・ 世界トップクラスに向けた事業成長戦略

■ 3：質疑応答

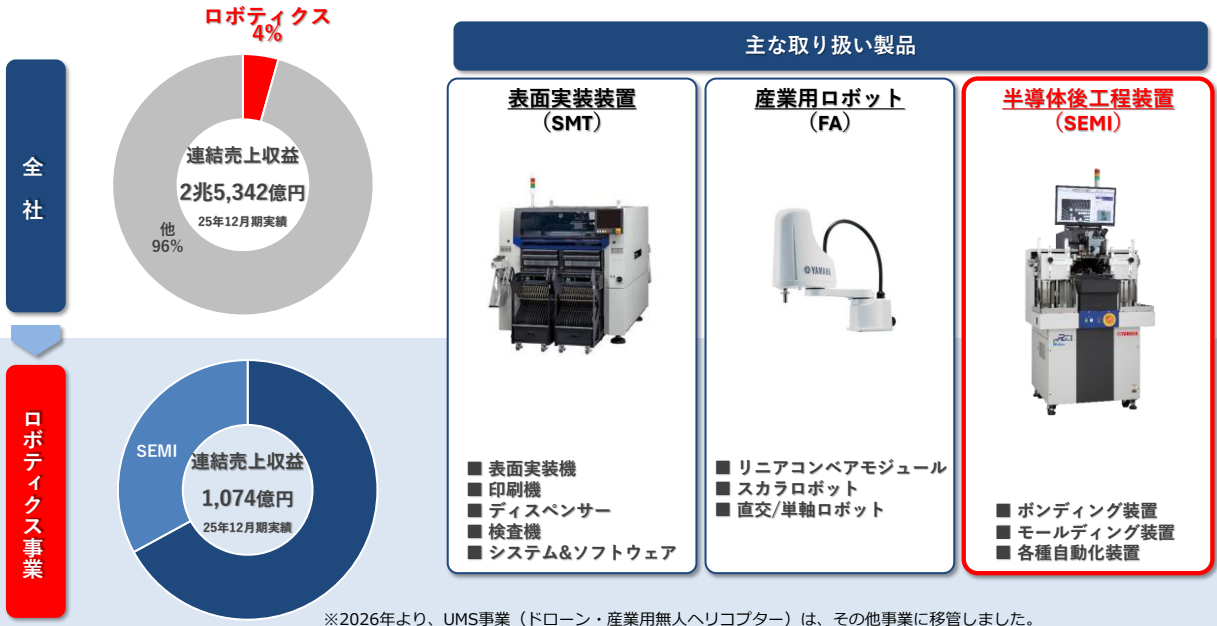
ロボティクス事業の概要

ヤマハ発動機株式会社
執行役員 ソリューション事業本部長
江頭 綾子

Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

3

(江頭)
ソリューション事業本部の江頭でございます。
始めに私から、ヤマハ発動機のロボティクス事業の概要についてご説明させていただきます。



まず、ビジネス概要についてご説明いたします。

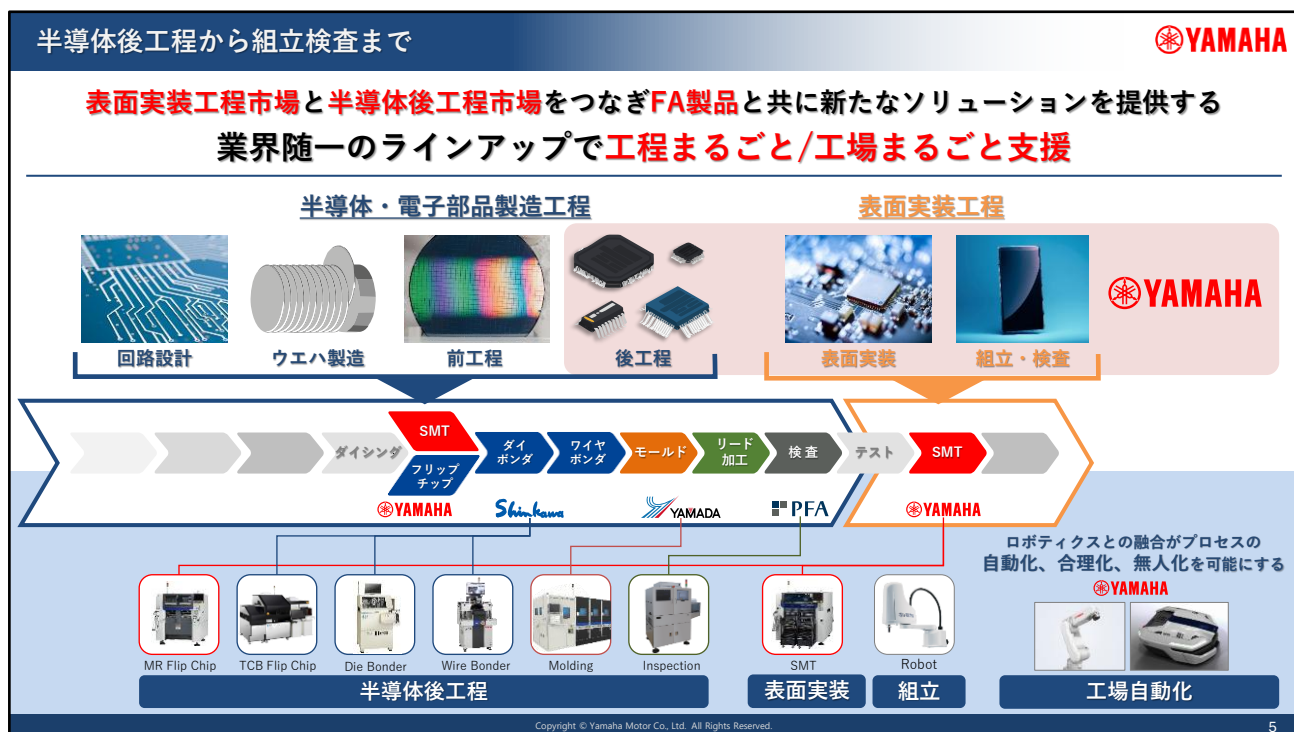
ロボティクス事業は、2025年12月期に売上収益1,074億円となり、ヤマハ発動機の将来の成長を担う戦略事業の一つと位置付けています。

また、近年進めてきた収益構造改革や事業統合の成果により、収益性も着実に改善しており、通期見通しでは営業利益率も二桁水準が視野に入るところまできています。

事業は、電子基板の製造工程を支えるSMT、生産設備の自動化を支えるFA、半導体の後工程を支えるSEMIの三領域で構成されています。

三事業が持つ装置、ソフトウェア、プロセス技術、サービスを組み合わせ、個別装置の販売にとどまらず、お客様の生産工程全体の課題解決を支援できることが、当社の特長です。

中でもSEMI事業は、生成AIの普及に伴って重要性が高まる半導体後工程において、ロボティクス事業の成長を牽引する中核領域と位置付けています。



こちらは、半導体が製造され、電子基板に実装され、最終製品へ組み込まれるまでの工程を示しています。

当社グループは、半導体後工程、表面実装、組立・検査を支える装置とソリューションを展開しています。

当社が目指す1 Stop Smart Solutionは、単に複数の装置を揃えるものではありません。

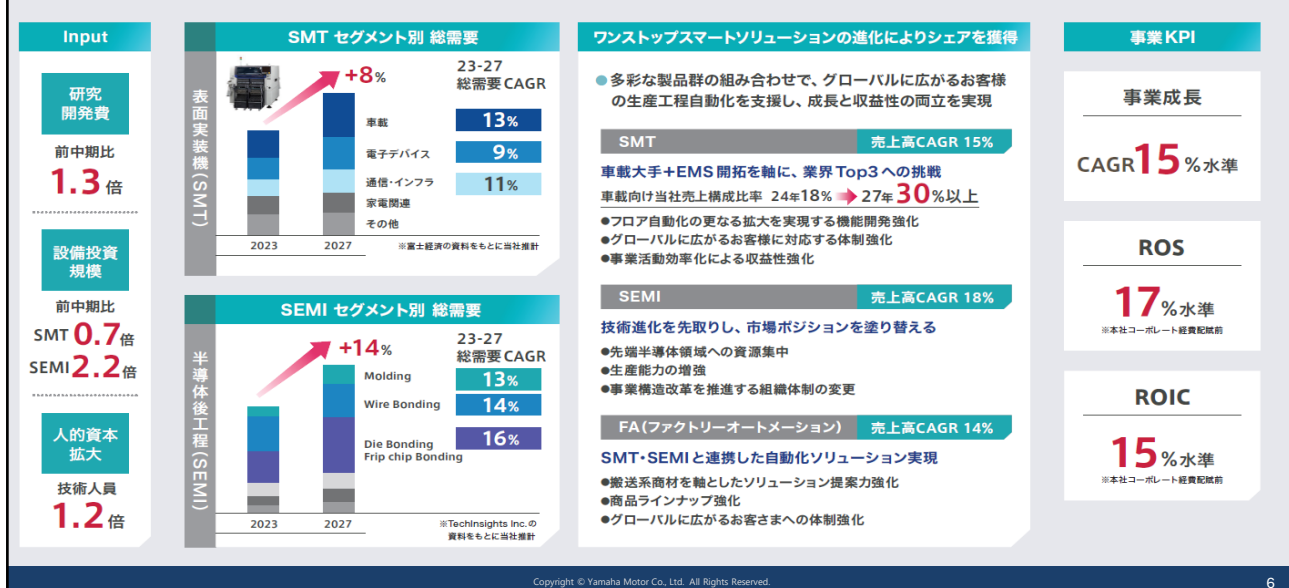
装置、ソフトウェア、検査、自動搬送、サービスを連携させ、「止まらない」「不良を作らない」「作業者への依存を減らす」生産工程の実現を支援するものです。

当社は、個々の装置性能だけでなく、半導体後工程から表面実装、組立までをつなぐ工程全体の最適化によって、お客様の生産性向上と競争力強化に貢献しています。

また、SMT、FA、SEMIが共通のお客様に対して一体となってアプローチすることで、工程ごとの課題ではなく、生産現場全体の課題を共有し、最適なソリューションを提案できることも当社の強みです。

この工程横断の提案力こそが、ロボティクス事業の成長を支える重要な競争優位です。

加速するデジタル社会と変革するモビリティを「ワンストップスマートソリューション」で支える



最後に、ロボティクス事業の中期経営計画の進捗についてご説明します。

当社は、「加速するデジタル社会と変革するモビリティを、ワンストップスマートソリューションで支える」という方針のもと、研究開発、人材、生産能力、販売・サービスへの投資を進めています。

研究開発では、SMT事業におけるコスト競争力の高いモデルやAIサーバー向け機能の開発に加え、SEMI事業では技術研究本部を設置し、先端半導体に対応する技術開発を進めています。

また、生産面では国内外の拠点を活用した生産レイアウト再編やモノづくり改革を進め、受注を確実に売上へ転換するための体制強化を進めています。

あわせて、技術人材の採用・育成や、ヤマハロボティクス株式会社統合後の事業横断的なリソース活用、海外拠点の体制再編やインドでの販売サービス機能開設などを通じて、グローバルな顧客対応力も強化しています。

このような投資を進める一方で、市場環境には分野ごとの濃淡があります。

SMT事業では車載市場の設備投資に慎重さが見られる一方、生成AIの普及を背景に、AIサーバーやデータセンター向けの高密度・高品質実装需要が拡大しています。

当社は、車載分野で培った品質保証、トレーサビリティ、自動化技術をAIサーバー領域にも展開し、顧客評価の積み上げと供給体制の強化を進めています。

車載市場の中長期的な成長機会を追求しながら、足元で拡大するAI関連需要を着実に取り込んでいきます。

また、SEMI事業では先端半導体領域、FA事業ではSMT・SEMIと連携した自動化ソリューションを成長の重点領域と位置付け、経営資源を重点的に投入しています。

このように、中期経営計画で掲げた重点施策は着実に進捗しており、市場環境の変化を成長機会として捉えながら、将来の成長につながる事業基盤の強化を進めています。

先進ロボティクス技術×トータル・ソリューションングのプロ集団として
世界中の『モノづくり』に関わる人たちが叶えたい自動化を
美しく、スマートに実現します

ART for Human Possibilities

人はもっと幸せになれる

Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

7

当社は、先進的なロボティクス技術と、工程全体をつなぐソリューション力によって、世界中のものづくりの生産性、品質、働き方の変革に貢献していきます。そして、こうした強みを生かしながら、市場環境の変化を成長機会として捉え、お客様への価値提供を通じて、ロボティクス事業のさらなる成長と収益性向上を実現してまいります。

続いて、成長を牽引するSEMI事業について、ヤマハロボティクス株式会社代表取締役社長の中村から、ご説明いたします。

ヤマハロボティクス SEMI事業成長戦略

ヤマハロボティクス株式会社
代表取締役社長
中村亮介

Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

8

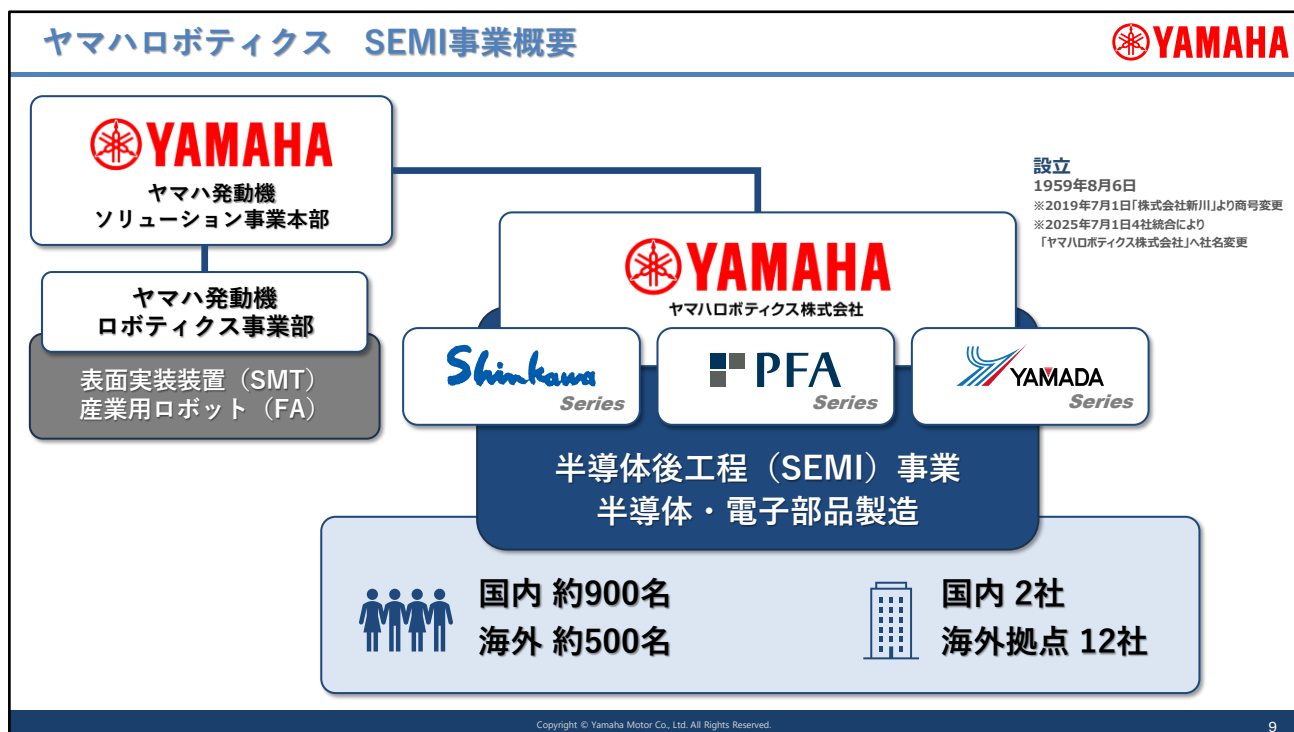
(中村)

ヤマハロボティクスの中村です。

ここからは、当社SEMI事業の成長戦略についてご説明します。

本日お伝えしたいポイントは、

- ・なぜ半導体後工程が今後の成長市場なのか、
- ・その市場でなぜ当社が勝てるのか、
- ・そして成長をどのように収益へつなげるのか、この3点です。



ヤマハロボティクスは、ヤマハ発動機のロボティクス事業の中で、半導体後工程を担う中核企業です。

2025年の4社統合により、技術、人財、販売・サービス網を一つにし、成長市場への対応力を大きく強化しました。

現在は国内外約1,400名、国内2社、海外12拠点の体制で事業を展開しています。新川、アピックヤマダ、PFAが長年培ってきた専門技術と、ヤマハ発動機グループの総合力を組み合わせ、世界のお客様へソリューションを提供しています。

統合の目的は規模を大きくすることだけではありません。

異なる技術を結集し、半導体後工程全体で、より大きな顧客価値を生み出すことです。



当社グループの特徴は、半導体後工程から表面実装、さらに組立工程まで、ものづくりの幅広い領域をカバーしていることです。
個々の装置を提供するだけでなく、生産性、品質、省人化というお客様の経営課題に対し、工場全体を最適化するトータルソリューションを提供できます。
この事業領域の広さが、単体装置メーカーとの大きな違いです。

当社の競争優位は3つあります。
第一に、多様なニーズを短期間で形にする開発力。
第二に、世界のお客様を支えるグローバルな対応力。
第三に、工程全体を設計し、提案できるトータルソリューション力です。
フリップチップ、ダイ・ワイヤボンディング、モールドング、電子デバイス組立というSEMIの技術に、ヤマハ発動機の総合力を加えて
高信頼、高効率、高品質な生産を、単体装置からライン全体まで支援する「1 Stop Smart Solution」として提供していきます。

SEMI事業は後工程プロセスを高速・高精度で行う装置やソリューションをワンストップで提供

前工程 半導体の回路を作る



シリコンウエハに処理を施し回路を作成

後工程 組み立てて完成させる



ウエハを切断し、フレーム固定や電極接続、樹脂コーティングなどのプロセスを経て製品化

切る



■ ダイシング

回路が形成されたウエハをブレードなどで切り分けてチップ化

つなぐ



■ ダイボンディング

切り分けたチップをピックアップ。接合素材を用いて基板などに固定



■ ワイヤボンディング

固定したチップの電極、基板、外部リードフレーム等を金属ワイヤで接続

固める



■ モールドイング

樹脂などを用いてチップを封止

診る



■ 検査

外観検査、電気的特性検査

組む



■ 組立

半導体をカメラモジュールや電子部品に組み立て

Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

11

半導体製造は、大きく前工程と後工程に分かれます。

前工程ではシリコンウエハ上に回路を形成し、後工程ではそのウエハを切り分け、接続し、樹脂で封止し、検査し、最終製品として組み立てます。

わかりやすい言葉で言いますと「切る、つなぐ、固める、診る、組む」という工程が後工程です。

専門的には、ダイシング、ダイボンディング、ワイヤボンディング、モールドイング、検査、組立と呼ばれます。

近年、前工程の微細化だけで性能を高めることが難しくなり、複数のチップを高度に組み合わせる後工程の重要性が一段と高まっています。

当社は、こうした後工程の主要装置とソリューションをワンストップで提供し、半導体の進化を支えています。

アセンブリ
ソリューション

つなぐ

診る

Shinkawa
Series

ボンディング技術で最先端半導体をつなぐ

SHINKAWA Series



- ダイボンダ装置
- ワイヤボンダ装置
- フリップチップボンダ装置

【拠点】西東京事業所
浜松事業所

組む

診る

PFA
Series

半導体製造・電子部品実装用に多彩なFA装置を創り出す

PFA Series



- 各種FA装置
- 電子デバイス 半導体などのFA装置

【拠点】埼玉事業所

パッケージング
ソリューション

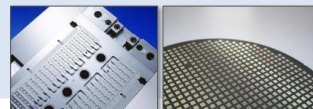
固める

診る

YAMADA
Series

先端半導体モールドでは業界トップクラス

APIC YAMADA Series



- モールド装置／金型
- リード加工装置／金型
- リードフレーム部品

【拠点】長野事業所
吉野工場

Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

12

当社のSEMI事業は、アセンブリソリューションとパッケージングソリューションで構成されています。

新川シリーズは、ダイボンダ、ワイヤボンダ、フリップチップボンダを通じて、半導体を高精度に「つなぐ」技術に強みがあります。

PFAシリーズは、半導体や電子部品の多様な組立ニーズを素早く形にする「組む」技術に強みがあります。

アピックヤマダシリーズは、モールド装置と精密金型により、半導体を高品質に「固める」技術に強みがあります。

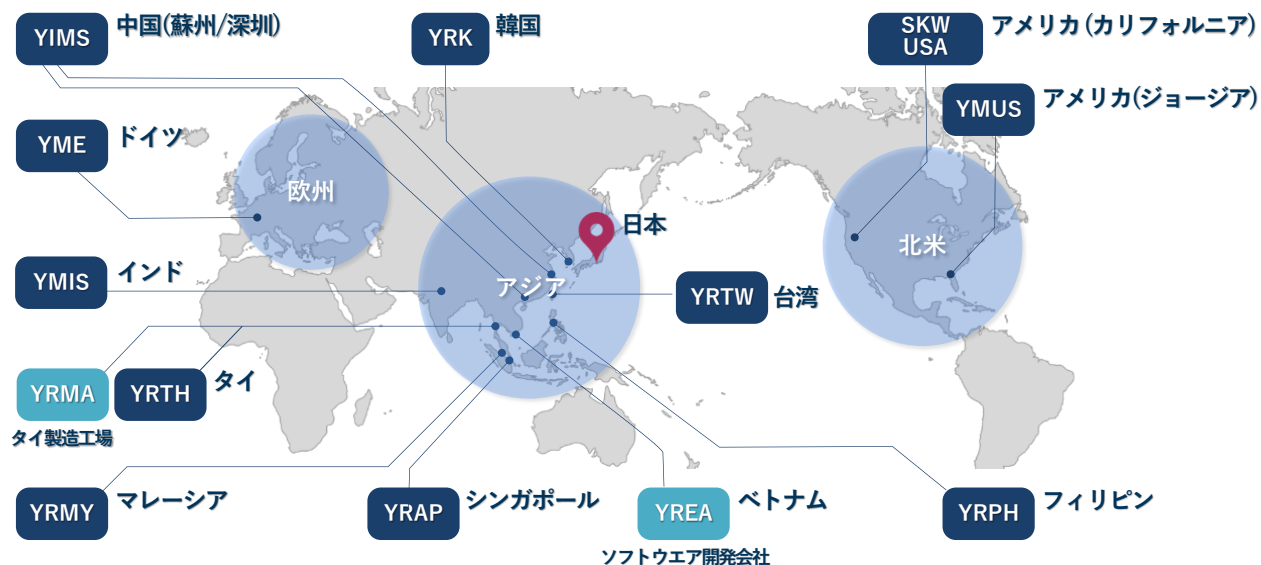
そして各工程に「診る」技術を組み合わせます。「つなぐ」「組む」「固める」「診る」を一体で提供できることが、当社独自の価値です。



国内では、東京本社を中心に、西東京、長野、埼玉、浜松、福岡に拠点を展開しています。

各拠点がそれぞれの強みと役割を担いながら、開発、生産、販売、サービスで連携しています。

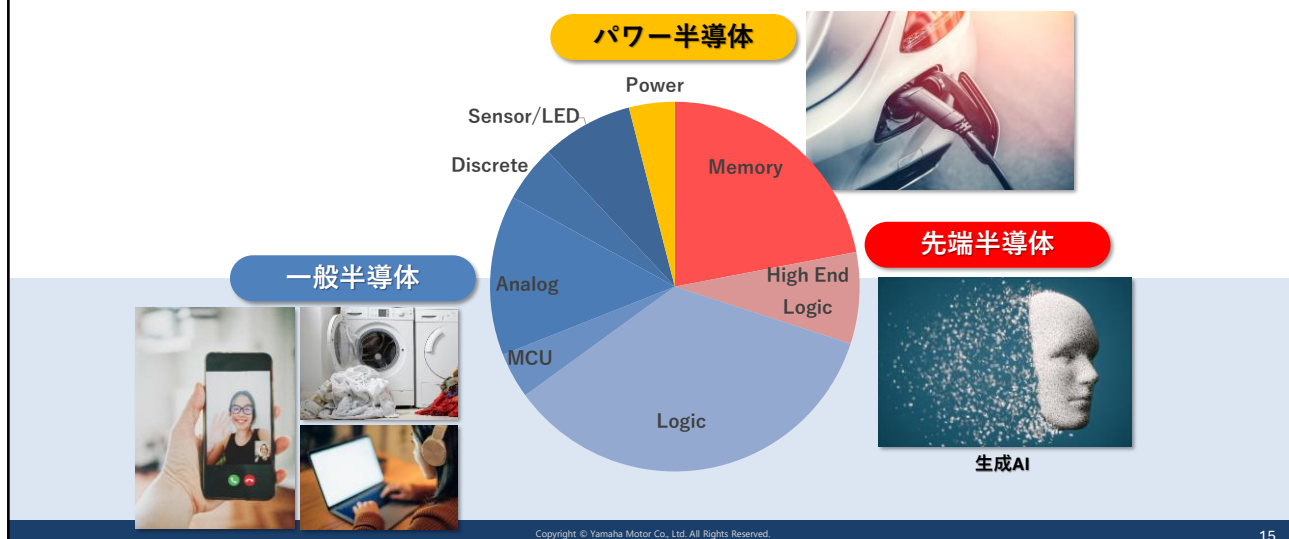
2025年の会社統合を機に、拠点間の技術交流と人財交流を進め、全社最適での事業運営を強化しています。



半導体市場は、世界各地に広がるグローバル市場です。
 当社は、半導体製造の中心であるアジアに加え、先端技術開発が集積する北米、欧州にも販売・サービス拠点を展開しています。
 また、タイに製造拠点、ベトナムにソフトウェア開発拠点を持っています。

販売・サポート力を高めるため、2025年7月に台湾拠点、2026年1月に欧州拠点を統合しました。
 さらに2026年4月にインドのロボティクス拠点を開所し、7月にはSEMI部門を追加しています。
 今後は北米、台湾、韓国など先端半導体の主要地域でサービス体制をさらに強化し、販売機会の拡大とサービス品質の向上につなげます。

成長領域の「先端半導体」「パワー半導体」、コア領域の「一般半導体」の進化
後工程ソリューションが半導体のさらなる進化を支える



Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

15

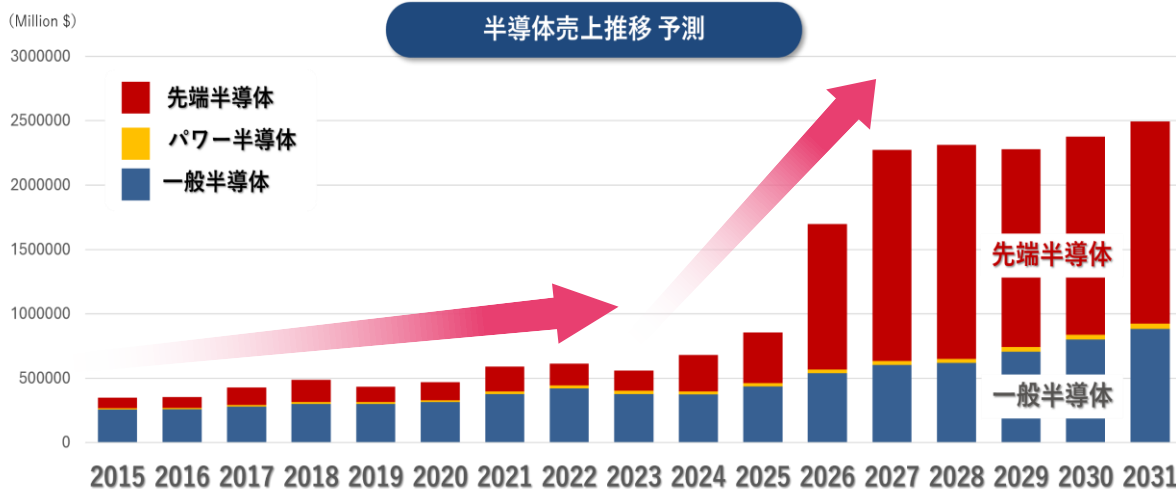
当社では、半導体市場を「一般半導体」「パワー半導体」「先端半導体」の3領域に分けて捉えています。

一般半導体は、成熟したパッケージを中心とする一方、数量の大きいボリュームゾーンであり、事業の安定収益を支える市場です。

パワー半導体は省エネルギー化や電動化を、先端半導体は生成AIを背景に成長しており、いずれもパッケージ構造の進化が続いています。

当社は、一般半導体で確実に稼ぎながら、パワー半導体と先端半導体で成長を取り込む、バランスの取れた事業ポートフォリオを構築しています。

AI時代の到来で半導体市場は想定を超える成長へ
2029年予測だった1兆ドル市場を2026年に前倒し達成見込み



※TechInsights Inc. "Semiconductor Forecast" をベースに当社で作成

Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

16

半導体市場は今、大きな転換点を迎えています。市場成長を牽引しているのは生成AIです。

半導体市場は2029年に1兆ドルを超えると言われていましたが、すでに2026年に1兆ドル突破を見込むほど急速に成長しています。

そのAIデータセンターには、高性能GPU、HBM、そしてそれらを高密度に実装する先端パッケージング技術が不可欠です。

そのため、半導体への投資だけでなく、後工程技術への投資も世界的に拡大しています。

重要なのは、この変化が一時的な景気循環ではないことです。

AIの普及に伴い、半導体の性能を左右する主戦場は、前工程の微細化に加えて、後工程の高度化へと広がっています。

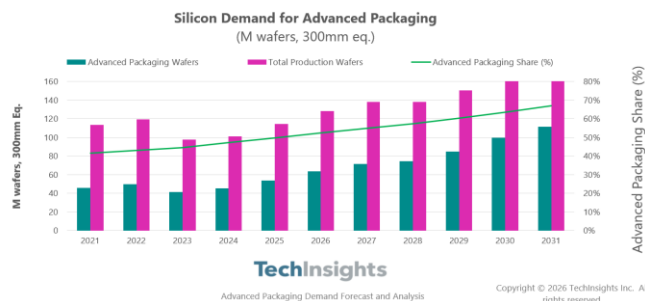
私たちはこの動きを中長期の構造変化と捉えています。

そして、その中心にある半導体後工程こそ、当社の事業領域です。

注力市場 先行投資により、AI成長を取り込むポジションを確立

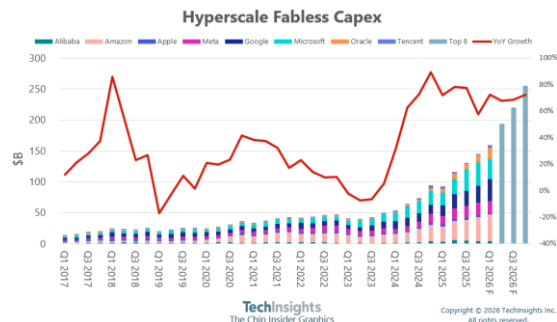


半導体市場のけん引役は先端半導体



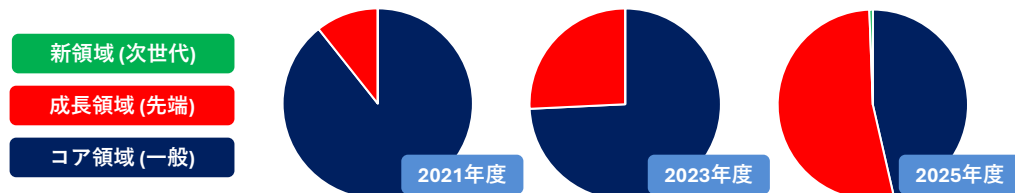
出典：TechInsights Inc.

AIデータセンターの投資は続く見通し



ヤマハロボティクス売上比率

成長領域の先端半導体向け売上が主役へ



Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

17

市場構造は先端半導体・AIデータセンター投資により、先端半導体中心に大きく構造変化しています。

この市場構造の変化に合わせ、当社の売上構成も大きく変化しています。

2021年度は一般半導体向けのコア領域が中心でしたが、2025年度には先端半導体向けの成長領域が事業成長の主役へと変わりつつあります。

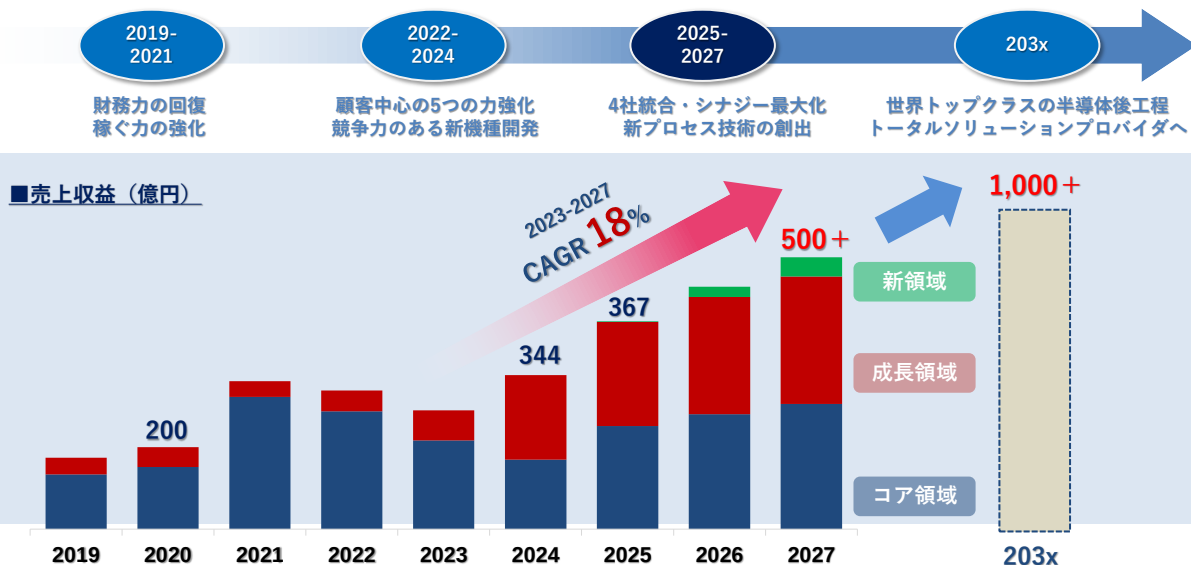
これは、市場が伸びた後に対応した結果ではありません。

当社は市場拡大に先行して、フリップチップボンダや先端モルディングへの技術投資と顧客提案を継続してきました。

その先行投資が、生成AI需要の本格化とともに成果として表れ始めています。

AI市場の成長を取り込めるポジションを、すでに築いてきたことが当社の強みです。

コア領域で稼ぎ、成長領域で伸ばし、新領域で未来を創る。



Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

18

私たちの成長戦略はシンプルです。

「コア領域で稼ぎ、成長領域で伸ばし、新領域で未来を創る」

この3層構造で事業を拡大しています。

コア領域の一般半導体向けのボンダやモールド装置を安定収益の基盤とし、その収益を原資に、成長領域の、AI、HBM、先端パッケージなどの高成長分野へ投資します。

さらに、新領域のシリコンフォトリソグラフィをはじめとする新技術へ先行投資し、次の成長ドライバーを育てます。

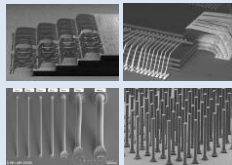
2019年のM&AによるSEMI事業の本格的強化から開始し、財務力の回復、競争力のある新機種開発、そして4社統合・シナジー最大化と着実に成長の手を打ってきています。そして今中期では2027年に売上収益500億円以上、そして長期では1,000億円以上を目指しています。

2025年の4社統合によって技術、人財、生産、販売・サービスの力を結集し、次なる成長戦略を実行する土台が整いつつあります。

➡ **新プラットフォームモデルの市場投入状況**

高速・高精度ワイヤボンダ「UTC-RZ1」

- 小型/高生産性（面積生産性37%UP）
- 省エネ（電力△12%、エア△50%）
- 独自の自動化技術



高速・高精度なワイヤ接合技術と
小型・省エネ性能に強み

UTC-RZ1

マルチプロセスモールドディング装置「MS-R series」

- 高生産性/超高精度
- 汎用/拡張性
- 新開発のワークハンドリング機構
- 狭ギャップ成形/MUF
- フラッシュレス/チップ露出成形



精密金型技術による
最先端プロセス対応力に強み

MS-R series

- ユーザ評価認定も進み、2026年より売上本格化
- AIデータセンター向け各種製品、光トランシーバにて需要増
- 新プラットフォームをベースに次世代技術も開発中

- 多様な半導体製造プロセスに対応し認定評価も高評価
- ユニークなモールド技術による高品質・高生産性が評価され受注拡大

Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

19

成長を支える土台は、コア領域の収益力向上です。

コア領域では、2つの新プラットフォーム、高速・高精度ワイヤボンダ「UTC-RZ1」と、マルチプロセスモールドディング装置「MS-Rシリーズ」を昨年リリースしました。

UTC-RZ1は、高速・高精度なワイヤ接合に加え、小型化と省エネ性能を強みとしています。

AIデータセンター向け各種製品、光トランシーバーなど省電力向け半導体で需要が大きく伸びています。

MS-Rシリーズは、精密金型技術と多様な先端プロセスへの対応力とチップ露出成型など高い樹脂成型技術力が評価されています。

両製品とも顧客評価が進み、本格的な売上貢献が始まっています。

新プラットフォームの拡販によって、コア領域を安定収益を生み出すキャッシュエンジンとして強化していきます。



成長分野の技術開発へ集中投資

円形ウエハから四角（パネル）へのトレンドに合わせ対応

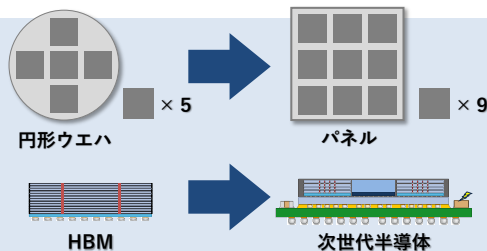
■ 次世代「パネルレベル」パッケージへの対応

フリップチップボンダ & モールディング装置

■ 先端半導体 新プロセスへの対応

HBM*多段化、高精度、高生産化、歩留まり向上

* HBM=高帯域幅メモリ



フリップチップボンダ

多様な次世代プロセスに対応
超小型・高速・汎用性が強み

- 次世代HBMに向けた高精度モデル 顧客評価
- パネルレベルパッケージ対応モデル発売
- 次世代プロセス向け要素開発も推進中

先端モールディング

精密金型技術を中心に
技術の引き出しが多く
最先端プロセス開発力に強み

- ウエハレベルパッケージ対応モデル 拡販
- パネルレベルパッケージ対応モデル 発売
- 新モールド技術 Zero-CCM工法 顧客評価開始

Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

20

ここが、今後の成長を牽引する先端半導体領域です。

生成AIの進化に伴い、HBMや次世代パッケージングの進化が進んでいます。

従来の丸い「ウエハ」から、四角い「パネル」型の素材を使って生産効率を高めたパネルレベルパッケージの進化。

また高性能メモリ「HBM」のさらなる進化や、2.5D/3Dといった積層化、異なるチップを高密度に搭載する「Chiplet」化が進んでいます。

このような先端半導体パッケージの進化を先取りするように、当社のフリップチップボンダ、先端モールディング装置も進化しています。

フリップチップボンダでは、超小型モジュール設計と独自の制御技術により、小型、高精度、高速、高汎用性を実現しています。

次世代HBM向け高精度モデルの顧客評価を進め、パネルレベルパッケージ対応モデルも市場投入しました。

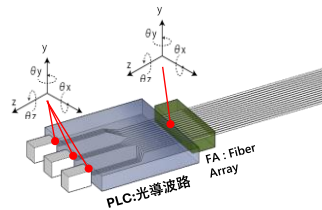
先端モールディングでは、精密金型を核とする高精度な樹脂成型技術が強みです。

現在主流となっているウエハレベルパッケージモールド装置の拡販に加え、次世代パネルレベルパッケージに対応したモデルも受注を開始しています。

またウエハやパネル端面まで高精度に樹脂成形するZero-CCMと呼ぶ新しいモールド技術の顧客評価も進んでいます。

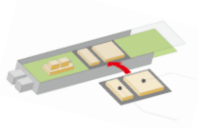
シリコンフォトニクス

-アクティブアライメント技術の応用で、高精度に光をつなぐ-
～電気接続から光接続実装で省電力化に貢献～

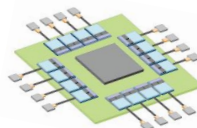


高速アクティブアライメント技術
高精度実装と自動化技術力に強み

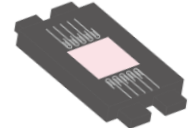
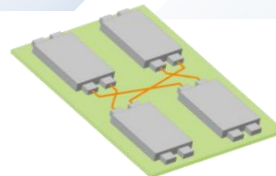
Transceiver / LPO
200Gbps~1.6Tbps



NPO
800Gbps~3.2Tbps



CPO
6.4Tbps~



*製品イメージ：各社資料を元に当社作成

Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

21

さらに次の成長の柱として取り組んでいるのが、シリコンフォトニクスです。
AIデータセンターでは、高速化とともに消費電力の抑制が大きな課題となっています。
その解決策として期待されるのが、電気信号の一部を光へ置き換える光電融合技術です。

この分野では、光を通しながら最適な接続位置を探索する、高速かつ高精度なアクティブアライメント技術が重要になります。
当社は長年培ってきた高精度実装とアクティブアライメント技術を応用し、研究用途から量産用途へ展開できるソリューションを開発しています。
市場が立ち上がってから参入するのではなく、市場が立ち上がる前に技術を確立する。これが当社の成長戦略です。

-大学・研究機関・企業との共創-

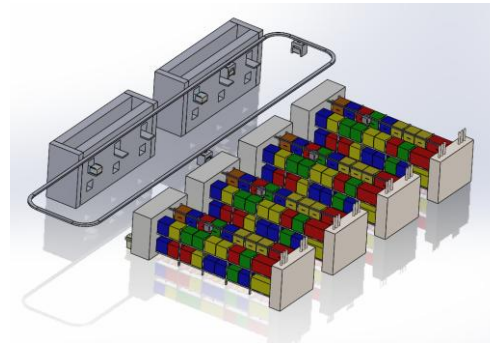
CEATEC AWARD 2025 イノベーション部門賞 受賞
※産総研・東京理科大様 共同開発・共同受賞

半導体後工程自動化・標準化技術研究組合(SATAS)へ加入
～半導体後工程におけるパッケージングプロセスの自動化に貢献～

-異物除去洗浄・表面異物検査技術-

-超音波非接触ハンドリング技術-

半導体製造の組立・検査工程（以下、後工程）の
省力化、自動化、それらに必要な標準化



* 出典：SATAS

将来の成長は、現在の研究開発投資から生まれます。

当社は、大学、研究機関、企業との共創を通じて、次世代の後工程技術を開発しています。

例えば共同開発の成果の一つであるチップレットオンウエハ接合技術の開発は、2025年のCEATEC AWARD イノベーション部門賞の受賞につながりました。

また、2026年3月には半導体後工程自動化・標準化技術研究組合、SATASへ正式加入しました。半導体製造後工程の自動化に取り組みます。

現在の事業を伸ばすと同時に、次世代プロセスと工場自動化の領域で未来の成長の種を育て、装置・プロセス・自動化を一体で提供する力へつなげていきます。

高付加価値化、生産改革、サービス収益、人財が成長と収益力向上を支える

■ 収益力強化

- ① 成長市場への集中投資
AI・HBM・光電融合向け拡大で高付加価値化
先端半導体向け売上拡大
生成AI市場成長を取り込む
- ② 生産改革・統合シナジー
原価競争力の向上
長野生産能力増強・タイ工場活用拡大
生産性向上・原価低減
- ③ ソリューション・サービス拡大
装置販売からライン提案へ
保守・アップグレード強化
サービス収益比率向上

■ 成長を支える人財基盤強化

- ① グローバル人財強化
新卒・キャリア採用強化
ヤマハブランド活用
海外人財採用拡大
- ② 技術力強化
大学・高専との連携
共同研究推進
次世代技術人財育成
- ③ 組織力向上
4社統合シナジー最大化
技術交流・共同開発
グローバル連携強化

Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

23

最後に、競争力強化に向けた、収益力の強化と人財基盤強化の取組みについてご説明します。

収益力強化の柱は3つあります。

第一に、成長市場への集中投資です。

AI、HBM、光電融合など成長市場への集中投資による高付加価値化と先端半導体、生成AI市場の取り込みを進めています。

第二に、生産改革と統合シナジーによるモノづくり競争力の向上です。

生産能力向上、海外工場活用、リードタイム短縮など、グループ力を活用してモノづくり力を強化しています。

第三に、ソリューション・サービス事業の拡大です。

装置を販売して終わるのではなく、保守、アップグレード、プロセス支援、ソフトウェア活用まで含め、お客様との長期的な関係と継続収益を拡大します。

次に、成長を支える人財基盤の強化です。

第一に、グローバル人財採用です。ヤマハブランドを活用しながら国内・海外の採用を拡大しています。

第二に技術力強化です。大学や高専との連携・共同開発を通じて、次世代技術人財の育成を進めていきます。

第三に組織力向上です。4社統合によるグループのベストプラクティスの横展開、技術交流やグローバル連携により組織力向上を進めています。

1 AI時代の半導体後工程成長を取り込み、売上を拡大

- ・生成AI、HBM、光トランシーバ向け需要が拡大
- ・成長市場への集中投資で受注を拡大
- ・先端半導体向けソリューションが成長を牽引

2 強いコア技術と統合シナジーで競争優位を確立

- ・「つなぐ」「固める」「組む」「診る」のコア技術を保有
- ・4社統合により開発・生産・販売・サービス力を強化
- ・1 Stop Smart Solutionで顧客価値を最大化

3 成長と高収益を両立し企業価値を向上

- ・コア領域で安定収益を創出
- ・先端半導体で高付加価値化を推進
- ・新領域への先行投資で持続的成長を実現

Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.

24

最後に、本日お伝えしたかったことを3点にまとめます。

1点目は、AI時代の半導体後工程の成長を取り組み、売上を拡大していきます。生成AIの普及によって、半導体後工程市場は中長期の成長局面に入っています。

当社は、HBM、先端半導体、光電融合などの成長市場へ経営資源を集中し、売上拡大を進めます。

2点目は、強いコア技術と統合シナジーで競争優位を確立します。

当社は「つなぐ」「固める」「組む」「診る」という強いコア技術を持ち、それらをワンストップで提供できる数少ない企業です。

4社統合とヤマハロボティクスグループの総合力を生かし、競争優位をさらに高めます。

3点目は、成長と高収益を両立し、企業価値を向上していきます。

コア領域で安定収益を創出し、成長領域で高付加価値化を進め、新領域へ先行投資することで、成長と高収益を両立します。

ヤマハロボティクスは、技術、生産、販売・サービス、人財の力を結集し、世界トップクラスの半導体後工程トータルソリューション企業を目指します。

本日はご清聴いただき、誠にありがとうございました。



本文書に含まれる技術内容は当社の秘密情報です。当社の許諾無く第三者への開示はできません。

The information contained in this message may be confidential and legally protected under applicable law. The message is intended solely for the addressee(s).
If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, forwarding, dissemination, or reproduction of this message is strictly prohibited and may be unlawful.

Copyright © Yamaha Motor Co., Ltd. All Rights Reserved.